

虹软科技股份有限公司

关于 2026 年半年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 调整前回购价格上限：不超过人民币 51.00 元/股（含）。
- 调整后回购价格上限：不超过人民币 50.88 元/股（含）。
- 回购价格上限调整起始日：2026 年 9 月 29 日（2026 年半年度权益分派除权除息日）。

一、回购股份的基本情况

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 51.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见 2026 年 8 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：临 2026-018）（以下简称《回购报告书》）。

二、调整回购价格上限的原因

根据公司 2025 年年度股东会审议授权，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第三

届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司 2026 年半年度利润分配方案即将实施，本次权益分派股权登记日为 2026 年 9 月 28 日，除权（息）日为 2026 年 9 月 29 日。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2026-027）。

根据公司披露的《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购价格上限的调整

根据《回购报告书》的约定，2026 年半年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 51.00 元/股（含）调整为不超过人民币 50.88 元/股（含）。具体的价格调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

由于公司本次权益分派涉及差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（399,594,024×0.12）÷401,170,400≈0.12 元/股。（保留两位小数）

根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的利润分配方案，公司本次仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

综上，调整后的回购股份价格上限=（51.00-0.12）÷（1+0）=50.88 元/股。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）。调整回购价格上限后，以公司目前总股本 401,170,400 股为基数，按照本次回购金额上限人民币 15,000 万元、回购价格上限人民币 50.88 元/股进行测算，回购数量约 294.81 万股，回购股份占公司总

股本的比例约为 0.73%；按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限人民币 50.88 元/股进行测算，回购数量约 196.54 万股，回购股份占公司总股本的比例约为 0.49%。具体回购股份的数量及金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日